

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分  
 【発行日】平成26年3月13日 (2014.3.13)

【公開番号】特開2013-107007(P2013-107007A)  
 【公開日】平成25年6月6日 (2013.6.6)  
 【年通号数】公開・登録公報2013-028  
 【出願番号】特願2013-50707(P2013-50707)  
 【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 5 1 2 Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年1月29日 (2014.1.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技動作を制御する制御回路が形成された制御基板と、ベース部材および蓋部材を組み合わせ  
合わせて箱状に形成され、内部に前記制御基板を収納する基板ケースと、ＩＣタグチップ  
および無線アンテナを有して前記基板ケースに貼付されるＩＣタグシールとを備えた遊技  
機であって、

前記ＩＣタグシールは、前記ベース部材および前記蓋部材を箱状に組み合わせたときに  
前記ベース部材および前記蓋部材の互いに隣接する部分により形成されるタグ貼付面に前  
記ベース部材および前記蓋部材に跨った状態で貼付され、

前記タグ貼付面に沿った方向にスライド移動させて着脱可能であり、前記タグ貼付面に  
貼付された前記ＩＣタグシールの表面を覆うカバー部材と、

前記カバー部材に形成された取付孔に外側から差し込まれて前記カバー部材に取り付け  
られる破断部材と、

前記タグ貼付面において前記カバー部材のスライド移動方向に延びるとともに、前記タ  
グ貼付面の外側まで延びるように前記基板ケースに形成されたスリットとを備え、

前記カバー部材が装着された後に前記破断部材が前記取付孔に差し込まれると、前記破  
断部材が前記タグ貼付面の外側において前記スリット内に挿入され、

前記カバー部材をスライド移動させて取り外すときに、前記スリット内に挿入された前  
記破断部材が前記カバー部材のスライド移動に伴って前記スリット内を前記スリットに沿  
って移動して前記タグ貼付面に貼付された前記ＩＣタグシールの少なくとも前記無線アン  
テナを含む部分を切断し、

前記カバー部材が取り外された後に前記ベース部材および前記蓋部材を分離させること  
により、前記ベース部材および前記蓋部材に跨って貼付された前記ＩＣタグシールが分断  
されるように構成されたことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本発明は、遊技動作を制御する制御回路が形成された制御基板と、ベース部材および蓋部材を組み合わせて箱状に形成され、内部に前記制御基板を収納する基板ケースと、ＩＣタグチップおよび無線アンテナを有して基板ケースに貼付されるＩＣタグシールとを備えた遊技機に関する。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１５】

（請求項１）

（特徴点）

請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。

すなわち、請求項１に記載された発明は、遊技動作を制御する制御回路が形成された制御基板(80)と、ベース部材(52)および蓋部材(53)を組み合わせて箱状に形成され、内部に前記制御基板を収納する基板ケースと、ＩＣタグチップおよび無線アンテナを有して前記基板ケースに貼付されるＩＣタグシール(12)とを備えた遊技機であって、前記ＩＣタグシールは、前記ベース部材および前記蓋部材を箱状に組み合わせたときに前記ベース部材および前記蓋部材の互いに隣接する部分により形成されるタグ貼付面に前記ベース部材および前記蓋部材に跨った状態で貼付され、前記タグ貼付面に沿った方向にスライド移動させて着脱可能であり、前記タグ貼付面に貼付された前記ＩＣタグシールの表面を覆うカバー部材(60)と、前記カバー部材に形成された取付孔に外側から差し込まれて前記カバー部材に取り付けられる破断部材(70)と、前記タグ貼付面において前記カバー部材のスライド移動方向に延びるとともに、前記タグ貼付面の外側まで延びるように前記基板ケースに形成されたスリット(58A, 58B)とを備えて構成される。そして、前記カバー部材が装着された後に前記破断部材が前記取付孔に差し込まれると、前記破断部材が前記タグ貼付面の外側において前記スリット内に挿入され、前記カバー部材をスライド移動させて取り外すときに、前記スリット内に挿入された前記破断部材が前記カバー部材のスライド移動に伴って前記スリット内を前記スリットに沿って移動して前記タグ貼付面に貼付された前記ＩＣタグシールの少なくとも前記無線アンテナを含む部分を切断し、前記カバー部材が取り外された後に前記ベース部材および前記蓋部材を分離させることにより、前記ベース部材および前記蓋部材に跨って貼付された前記ＩＣタグシールが分断されるように構成されたことを特徴とする。

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１６

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１６】

（請求項１の効果）

以上のように構成されている本発明は、以下に記載されるような効果を奏する。

すなわち、請求項１記載の発明によれば、ＩＣタグシールが基板ケースを構成するベース部材および蓋部材に形成されたタグ貼付面にベース部材および蓋部材に跨った状態で貼付され、そのＩＣタグシールの表面を覆うカバー部材を備えて構成される。そのため、ＩＣタグシールがカバー部材の内部に密閉され、ＩＣタグシールを基板ケースから剥がす際に、カミソリ等の刃物を利用することができなくなるうえ、化学薬品をＩＣタグシールに塗布することもできなくなる。従って、ＩＣタグシールのＩＣチップ、無線アンテナ及び外観等にダメージを与えずに基板ケースからＩＣタグシールを剥がすことが不可能となる。

。

【手続補正５】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

また、タグ貼付面においてカバー部材のスライド移動方向に延びるとともに、タグ貼付面の外側まで延びるように基板ケースに形成されたスリットを備え、カバー部材が装着された後に破断部材がカバー部材に形成された取付孔に差し込まれると、破断部材がタグ貼付面の外側においてスリット内に挿入され、カバー部材をスライド移動させて取り外すときに、スリット内に挿入された破断部材がカバー部材のスライド移動に伴ってスリット内をスリットに沿って移動してタグ貼付面に貼付されたＩＣタグシールの少なくとも無線アンテナを含む部分を切断する。そして、カバー部材が取り外された後にベース部材および蓋部材を分離させることにより、ベース部材および蓋部材に跨って貼付されたＩＣタグシールが分断されるように構成される。このため、基板ケースの開放の際に、確実にＩＣタグシールが破断され、剥がされたＩＣタグシールの再利用を確実に不可能にすることができ、これにより、前記目的を達成することができる。